

4/28

寬能帶功率半導體測試與材料應用(2)

寬能帶半導體(WBG)材料，如碳化矽(SiC)和氮化鎵(GaN)，能具有更好的耐高溫、高壓、高頻率、高電流，導熱性，並能將能量損耗降低，且體積更小，符合5G、電動車、再生能源、工業4.0的測試需求。立足於無線通訊及半導體測試領域20年的筑波科技，針對無線通訊/功率IC/異質材料檢測等領域，提供客戶需要的半導體測試設備系統、軟/硬整合方案服務。

在降低測試成本和加快上市時間的競爭壓力下，有哪些測試挑戰？ETS平台產品為業界最高規格之功率IC測試平台，獲得歐洲，美國，及亞洲區多個主要車用電子，PMIC設計商採用。本次研討會提供從WBG異質材料特性與技術著墨、PMIC等各領域IC自動化測試的實務分享。

我們邀請您與筑波科技專業團隊就市場和技術的最新趨勢探討及交流！歡迎寬能帶半導體產業領域的廠商先進主管報名參加。

Time	Topic	Speaker
PM 1:00~1:30	Registration 報到登記	
PM 1:30~1:40	Welcome 致歡迎詞	Richard Hsieh APAC Sales VP, Teradyne Steve Hsu Chairman of ACE
PM 1:40~2:10	WBG Power IC Market Trend 寬能帶半導體市場趨勢的機會與挑戰	Walter Chen GM, ACE
PM 2:10~2:40	Eagle High Power System Introduction Eagle 高功率系統架構特點介紹	Curtis Liao Sales Director, ACE
PM 2:40~3:10	WBG Compound SiC Materials Technology WBG化合物半導體碳化矽SiC材料技術	Dr. KC Chiu Material and Chemical Research Laboratories, ITRI
PM 3:10~3:40	Brief Compound Materials Characteristics Analysis 化合物半導體異質材料物理特性分析	Dr. Chan-Shan Yang Professor, NTNU
PM 3:40~4:10	Tea Break 中場休息&方案展示	
Workshop Group		
PM 4:10~4:20	A: Eagle system introduction (Eagle 系統各部功能展示介紹)	ACE/Teradyne
PM 4:20~4:30	B: Eagle Vision S/W Tools introduction	ACE/Teradyne
PM 4:30~4:40	C: Major Tx/Rx Characteristics test for WBG device (WBG 材料/Wafer特性測試)	ACE/Teradyne
PM 4:40~5:00	Q&A 會後討論	

活動日期: 2022年04月28日(四) PM1:00 – PM5:00

活動地點: 新竹縣竹北市生醫二路66號 筑波醫電大樓 (新竹生醫園區)

報名方式: 03-5500909 ext. 3407林小姐/ 3502 鄭小姐

service@acesolution.com.tw

線上報名: http://register.acesolution.com.tw/2022_ACE&Teradyne_Webinar_0428



手機掃碼報名

TERADYNE



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co., Ltd.